|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **技術主題** | ○○○○○○○○○○潛力學程 | | | **學程**  **經費** | ○○○○○○元  (委辦款及企業出資總計) |
| **申請單位** | ○○○○○○○○○○ | | | | |
| **執行期間** | 112/○○/○○-112/○○/○○ | **時數** | ○○ | **預計人數** | ○○ |
| **培訓地點** |  | | | | |
| **需求單位**  **(企業)** |  | | | | |
| **學程對象** | 說明適訓學員條件，例如新南向國際生、國內頂尖大學之基礎科學科系、私立前段大學之電機電子相關科系、企業新招募人才。 | | | | |
| **前瞻範疇** | □高階設計：□系統架構 □高階射頻 □記憶體 □電力電子 □前瞻製程佈局 □測試  □高階製程與材料：□奈米製程 □先進設備 □元件製程整合開發  □高階封裝：□先進封裝研發 □先進設備  □其他 | | | | |
| **學程方向與**  **前瞻主題規劃** | 填寫說明:  本課程之規劃，係因應何種業界實務需求或何種新興應用趨勢。說明業界對本課程內容有明確需求，或可支援某特定技術之發展。   * 學程方向 (規格定義、製程選定、架構選擇、電路設計、設備升級…) * 主題式前瞻技術規劃(如製程新材料研發、量子運算與元件、AI加速器、5G晶片) * ○○○○○○期契合業界職務需求…… | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **編號** | **課程名稱** | | **課程大綱**  **(實作部分須說明教學設計及使用設備名稱)** | | | **授課專家** | **時數** |
| 1. |  | |  | | |  |  |
| 2. |  | |  | | |  |  |
| 3. |  | |  | | |  |  |
| 合 計 | | | | | | |  |
| **專家(顧問/講師)資料** | | | | | | | |
| **授課師資** | | **學/業** | | **最高學歷/經歷** | **專長** | | |
|  | |  | |  |  | | |
|  | |  | |  |  | | |
|  | |  | |  |  | | |

|  |
| --- |
| **預期成果/效益評估**（人才媒合率/留任率須於年底達5成以上） |
| 填寫說明：請依合理性、適切性及可達成度審慎自評，請以文字說並填答質量化指標，以利委員審查。  說明：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **量**  **化**  **指**  **標** | **人力資源** | \*擇1填列  培育人數： 人，預計媒合人數： 人  企業人才訓練成本減少　 元、上手時間縮短\_\_\_\_  其他：請說明 | | **工作效能** | \*擇1填列  人均產值上升\_\_\_\_%、工作成本下降\_\_\_\_%、作業良率提升\_\_\_\_%、專案開發時間減少\_\_\_\_%  其他：請說明 | | **質**  **化**  **指**  **標** | **促進實務**  **工作應用** | 填寫說明：請說明預期職員結訓後具備的專業技能，並評估對產業或區域發展之助益。 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **專家(顧問)**  **簽名/日期** |  | **企業專案負責人**  **簽名/日期** |  |

* + **同意加入公私(產學)共育國內外高階人才計畫之國際產學交流聯盟會員。**
  + **已屬公私(產學)共育國內外高階人才計畫之國際產學交流聯盟會員。**